



Laser marking and engraving system
Sistema di marcatura e incisione laser

BIG SMARK

VERSATILITY

Increased functionality of the laser source allows for **engraving, marking** and **cutting** to meet the highest technical standards available.

WIDE WORK CHAMBER

The **500 mm x 500 mm** work chamber (maximum piece height 530mm with F100 focal lens) is easy to access thanks to the door that opens on three sides.

FLEXIBLE SYSTEM

It can be integrated with all Sisma accessories as well as the **Coaxial Vision System** and the **Pattern Matching** software.

ADVANCED SOFTWARE

Entirely developed by Sisma, the **integrated software** is the ideal solution for file management and parameters defining, even for **complex jobs**.

VERSATILITÀ

Le funzionalità avanzate della sorgente laser consentono di eseguire lavorazioni di **incisione, marcatura** e **taglio** in linea con gli standard tecnici più elevati.

AMPIA CAMERA DI LAVORO

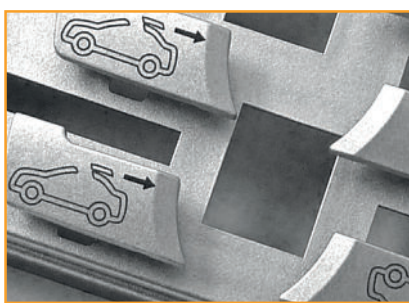
La camera di lavoro di **500 mm x 500 mm** (altezza massima del pezzo 530 mm con focale F100) ha un accesso facilitato grazie all'apertura su tre lati.

SISTEMA FLESSIBILE

Può essere integrato con tutti gli accessori Sisma oltre al sistema CVS (**Coaxial Vision System**) e al software di **Pattern Matching**.

SOFTWARE AVANZATO

Interamente sviluppato da Sisma, il **software integrato** è la soluzione ideale per la gestione dei file e la definizione dei parametri, anche nel caso di **lavorazioni complesse**.



Technical Data - Dati tecnici

Technical Data - Dati tecnici	200F	200F EP	300F	400F	500F	700F	1000F	GREEN	UV
Laser source - Sorgente laser	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Nd:YVO4	Nd:YVO4
Wavelength - Lunghezza d'onda	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	532 nm	355 nm
Average laser power - Potenza media laser	20 W	20 W	30 W	40 W	50 W	70 W	100 W	10 W	3 W
Pulse frequency - Frequenza impulso	1÷500 kHz	1÷1000 kHz	1÷500 kHz	1÷1000 kHz	1÷500 kHz	1÷500 kHz	CW÷1000 kHz	1÷300 kHz	1÷300 kHz
Pulse duration - Durata impulso	260/40 ns	3-500 ns	260/40 ns	10-240 ns	250/40 ns	260/40 ns	17/500 ns	30 ns	35 ns
Max pulse energy - Energia max impulso	1/0,21 mJ	0,03-1 mJ	1/0,21 mJ	0,16 - 1,33 mJ	1/0,21 mJ	1/0,21 mJ	0,1/1 mJ	0,25 mJ	0,075 mJ
Beam quality - Qualità del fascio	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 3,5 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,2 M ²	≤ 1,3 M ²
Laser spot diameter - Diametro spot laser	20 µm	20 µm	20 µm	40 µm	20 µm	20 µm	20 µm	12 µm	7 µm
Max marking speed - Velocità di marcatura max	2000 mm/s					5000 mm/s		2000 mm/s	
Focal lenses - Lenti focali	F100, F160 (standard), F254, F330							F100, F160	F160
4 th axes - 4° asse	Optional								
Guide laser - Guida laser	Class 2M Red Laser Diode; λ=650 nm; 2 mW								
Working temperature - Temperatura di lavoro	10°C to 35°C - non condensing								
Cooling system - Sistema di raffreddamento	Forced-air cooling						Water	Forced-air cooling	
Working chamber - Camera di lavoro	500 x 500 x 380 mm								
Power supply - Alimentazione	230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW								
Dimensions (WxDxH) - Dimensioni (LxPxH)*	650 x 1040 x 1760 mm								
Weight - Peso	240 kg								

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.
Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

02-2018



SISMA S.p.A.
via dell'Industria 1, - 36013 Piovone Rocchette (VI) Italy
tel. (+39) 0445 595511 - fax (+39) 0445 595595
info@sisma.com - www.sisma.com

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
ISO 9001**